

技術項目說明

本計畫執行後，將可協助廠商建立低熱膨脹、耐磨損、高平面度、高平行度複材游標卡尺本體設計、製作關鍵技術，並建立國內自主性生產供應鏈，促進相關產業應用之開拓。高精度複材為業界殷切需求的技術，故此技術後續將有助於廠商承接國防及航太產品，並投入要求輕、薄且低變形量的 3C 產品開發。

